

檔 號：

保存年限：

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號

聯絡人：程稚茵

電話：02-2737-7232

傳真：02-2737-7619

電子信箱：parker@nstc.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年5月1日

發文字號：科會產字第1120024734號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2023未來科技獎徵件須知、「2023未來科技獎」暨參展報名資料表、2022未來科技獎獲選名單附件1 附件2 附件3

主旨：有關「2023台灣創新技術博覽會」辦理之未來科技獎徵件，自即日起受理，請查照並轉知所屬踴躍報名。

說明：

- 一、旨揭博覽會將於112年10月12日(四)至10月14日(六)於台北世貿一館展出，以成為國際研發交易樞紐平台為定位，由11大部會展示逾1600件國內前瞻技術，並邀請海外機構參展，共同展現我國創新技術能量。
- 二、徵件說明如下(請詳附件徵選須知)：
- 三、本案聯絡窗口：陳小姐，電話：(02)2576-2013、信箱：wenhua@mail.tca.org.tw

正本：專題研究計畫受補助單位 (共301單位)

副本：中央研究院、教育部、衛生福利部、本會各處室及所屬機關 (共10單位)、財團法人國家實驗研究院、財團法人國家同步輻射研究中心、國家災害防救科技中心、國家太空中心、台北市電腦商業同業公會(均含附件)